合金状態図と先端材料設計*

石田清仁**

1. はじめに

状態図は材料研究に不可欠な「地図」としての情報を提供 してくれるが、本多光太郎先生が活躍されていた時代には本 邦は状態図研究について世界的にも多大な貢献をし、重要な 研究成果を発表している。例えば有名な Hansen の状態図 集⁽¹⁾を見ると鉄鋼研究における最も重要な Fe-C 系状態図に ついて本多先生が Nature や東北大学理科報告などの専門誌 に1910年代後半から1930年代にかけて10編以上の論文を発 表している事がわかる。当時の状態図研究は主に実験状態図 を決定するものであったが,現在でもこの種の研究の重要性 には変わりがない.むしろ,実験状態図の決定には多大な労 力と費用がかかる地道な研究が求められるので,世界的にも 研究グループが激減していることが危惧される.状態図研究 にはこの「実験状態図」の他に「理論状態図」と「計算状態 図」がある.特に計算状態図については1970年代以降にコ ンピュータの普及とともに著しい進展があり,CALPHAD (Calculation of Phase Diagrams)法として確立されている. この事については第37回本多記念講演で西澤先生が詳しく 述べられているが⁽²⁾,現在の状況と比較すると大きく変化し た点は,第1原理計算の進展⁽³⁾と実用合金のデータベース

合 金 系	対象 元素	対象相		
Fe 基合金				
低合金鋼	Fe-C-N-Si-Mn-Cr-Mo-Ni-Co-Al-Nb-V-Ti-W	L, α, γ, 炭化物, 窒化物		
マイクロアロイング鋼	Fe-C-N-S-Mn-Si-Al-Cr-Ti-Nb-V	L, α, γ, 炭化物, 窒化物, 硫化物		
工具鋼	Fe-C-Cr-V-W-Mo-Co	L, α, γ, 炭化物		
ステンレス鋼	Fe-C-N-Si-Cr-Ni-Mn-Mo-Al	L, α, γ, 炭化物, 窒化物		
低比重鋼	Fe-C-Mn-Al-Cr-Si	L, α, γ, 炭化物		
硫化物	Fe-C-S-Cr-Ni-Mn-Ti	L, α, γ, 硫化物, 炭化物		
Ni 基合金	Ni-Al-Ti-Cr-Mo-Co-Ta-Nb-Zr-W-Hf-B-C	L, γ , γ' , β , TCP (σ , μ , Laves), 硼化物, 炭化物		
Ti 基合金	Ti-Al-V-Mo-Cr-Si-Fe-Nb-Sn-Ta-Zr-B-C-N-O	σ, β, 化合物, 硼化物, 炭化物		
Al 基合金	Al-Cr-Cu-Fe-Mg-Mn-Ni-Si-Ti-V-Zn-Zr	L, α, 金属間化合物		
Mg 基合金	Mg-Al-Ca-Ce-Gd-Li-Mn-Nd-Sc-Si-Sr-Y-Zn-Zr	L, α, β, γ, 金属間化合物		
Cu 基合金	Cu-B-C-Cr-Fe-Ni-P-Si-Sn-Ti-Zn	L, α, β, γ, 金属間化合物		
化合物半導体	Al-Ga-In-P-As-Sb	L, 化合物		
マイクロソルダー材	Pb-Sn-Ag-Cu-Bi-Sb-Zn-In-(Al)-(Au)-(Ni)	L, α , β , γ , δ , 金属間化合物		
Co 基合金	Co-Al-Cr-W-Ni-(Ta)-(Mo)-(C)	L, α, ε, 金属間化合物		

表1 実用合金の熱力学・状態図データベース.

* 2010年3月28日, 筑波大学筑波キャンパスにおける第146回本会春期大会において講演

** 東北大学教授(現:東北大学名誉教授);大学院工学研究科(〒980-8577 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-02)

Alloy Phase Diagrams and Design of Advanced Materials; Kiyohito Ishida (Emeritus Professor, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai)

Keywords: phase diagram, phase transformation, phase stability, alloy design, microstructural control, computer calculation, CALPHAD, database, sulfide, heat treatment, low alloy steel, high Mn steels, Ni-base alloys, Co-base alloys, superalloys, liquid miscibility gap, alloy powder 2009年11月25日受理

の充実を挙げる事ができよう.第1原理計算によって安定 相だけでなく,準安定相の電子状態を計算し,それを自由エ ネルギーの枠組みに導入する事によってより信頼性の高い熱 力学データの推定が可能となった.さらに,各種実用合金の 多元系状態図と熱力学的性質を計算するためのソフトウェア も開発されたので,現在では**表1**に示す様に多くの合金系の データベースが構築されている⁽⁴⁾.本稿では,合金状態図に 関する筆者らの最近の研究成果⁽⁵⁾とそれを応用して先端材料 を設計し,開発した例について紹介する.

2. 鉄-硫化物系状態図と Pb フリー快削鋼

鉄鋼中に生成する FeS, MnS などの硫化物は熱間加工 性,機械的性質や耐食性等に大きな影響を及ぼす事は知られ ているが、オキサイドメタラジーでは組織微細化の有効因子 との一面も有している.また,古くから MnS は硫黄快削鋼 として材質制御のために積極的に利用されている他, MoS₂ やWS2は固体潤滑剤として実用的にも重要である.表1に 示す鉄鋼の状態図データベースの中でも主要な置換型合金元 素やC,Nを含む実験および計算状態図についての研究は多 く行われてきた.しかし,Sを含む系に関しては金子らによ る先駆的研究はある(6)が、限られた系しか行われていない. そこで筆者らはいくつかの重要な Fe-S 基合金の状態図につ いて実験並びに熱力学的解析を行ない、過去に報告されてい る熱力学パラメータと組み合わせる事により Fe-Cr-Mn-Ni-Ti-S-C系の状態図 · 熱力学データベースを構築し, IF 鋼やステンレス鋼等の実用鋼中に生成する硫化物や炭・硫化 物の相平衡を計算可能とした(7).

図1に計算例⁽⁸⁾として Fe-Mn-S系の Fe: Mn=97:3の 垂直断面状態図を Vogel ら⁽⁹⁾の熱分析データとともに示し た.図1(a)に示した計算結果は、Vogel らの熱分析結果を 解析の際に考慮に入れていないにも関わらず、計算された相 境界と一致している.一方,彼らが報告した図1(b)の状態 図を計算結果と比較すると構成されている相境界が大きく異 なっている.彼らの状態図中の相境界は,熱分析結果と組織 観察による形成過程の考察から推測しているため不正確な部 分が生じたと考えられ,EPMAやX線回折から決定された 等温断面図に基づいて計算された状態図が信頼できると言え る.以上の様に現在かなり信頼性の高い熱力学データベース が構築されているが,図2に熱力学計算から求めたCrS, MnS および TiS の溶解度積の温度依存性を TiN,TiC の値 と合わせて示した.図面中では省略しているが,多くの炭化 物,窒化物の溶解度積は,TiNやTiCのようにオーステナ イト相の方がフェライト相よりも大きくなる.一方,硫化物 の場合はオーステナイト相の方がフェライト相よりも小さく なるという逆の傾向を示すのが特徴である.

上記の硫化物の熱力学データベースを利用し、硫化物の組織形態制御を行う事によって Pb フリー快削鋼の開発を行っているので紹介する.環境問題から工業製品への Pb の利用は規制されつつあり、快削鋼中に含まれる Pb も例外ではな





図1 Fe-Mn-S系のFe: Mn=97:3の垂直断面図. (a) 計算, (b) 実験.

い. Pb にかわる被削性改善物質としては MnS が多く研究 されている.しかし,腐食されやすい MnS をステンレス鋼 中に分散させることは耐食性を劣化させることになるため望 ましくないので、著者らは Ti₄C₂S₂ に着目した.図3にフェ ライト系ステンレス鋼である SUS430をベースとした合金の 800℃における等温状態図を示す(5)(10).種々の炭化物や硫化 物の安定性が接近しているため、僅かな C, S 濃度の違いに より析出する化合物が変化する.また、フェライトマトリッ クス中に Ti₄C₂S₂のみが析出する α+Ti₄C₂S₂2相領域は非 常に狭く、実際の製鋼工程において成分コントロールするこ とは困難であることが示唆される.一方, $M_{23}C_6$ やTiCな どの炭化物は硬い化合物であり、工具摩耗を助長すると考え られ、被削性への悪影響の観点からその析出を避ける必要が ある. 従って, 被削性や耐食性への影響が小さい TiS が共 存する α+Ti₄C₂S₂+TiS の3相領域でTi₄C₂S₂がより多く析 出する組成範囲がステンレス快削鋼として好ましい. このよ



図3 Fe-0.21Si-0.7Mn-16.5Cr-0.55Ti-C(mass%)合 金の800℃における等温状態図.



図4 Ti₄C₂S₂を分散させたフェライト系快削ステンレ ス鋼の工具の逃げ面摩耗量.

ま て り あ 第49巻 第6号(2010) Materia Japan

うな合金設計指針のもとに、幾つか合金を溶製し、その被削 性や耐食性などを比較した.図4は、旋削試験による工具の 逃げ面磨耗を評価した結果を示している⁽¹¹⁾. Alloy I は合 金組成が図3中にIで示された点に近い組成で、Ti₄C₂S₂が 多く析出している. Alloy ⅡはCを減量し,合金組成が図3 中にⅡで示された点に近い組成で TiS が多く析出している. Alloy Ⅲは C 濃度を増量した合金で, M₂₃C₆ が多数析出する 合金である.この結果から、Ti₄C₂S₂が多く析出した Alloy Iの工具磨耗量が他の合金と比較して少なく、Pbを分散さ せた SUS430+Pb に匹敵することが明らかとなった.この ことは、Ti₄C₂S₂が切削性改善に有効であることを意味して いる. 開発鋼(Alloy I)は, 被削性だけでなく耐食性や機械 的性質, さらに冷間加工性も SUS430F よりも優れることも 明らかとなっている⁽¹²⁾. 著者らは, このような CALPHAD 法による合金設計を応用して、Pb フリー快削ステンレス鋼 だけでなく、 $Ti_4C_2S_2$ を分散した軟磁性鉄合金、インバー合 金, Ti 合金, Ni 合金の快削化にも成功している.

3. Cu-Al-Mn 基および Ni-Mn 基形状記憶合金

(1) Cu-Al-Mn 基形状記憶合金

Cu-Al-Mn 系の bcc 相である β 相には古くから強磁性の L2₁ホイスラー構造 Cu₂MnAl 相の出現が知られている.図 5(a)の850°C等温状態図⁽¹³⁾に示すように、この β 相は広い組 成範囲に存在するので Mn や Al を低下させる事によって規 則度を低下させ延性のある β 相を得られる可能性を示唆し ている.事実,図 5(b)の Cu-Al-10 at% Mn の垂直断面図に 示すように⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾A2/B2(T_c^{A2-B2})および B2/L2₁(T_c^{A2-L2})規 則化温度は、Al 濃度に敏感であり、Al 濃度が18%以下にな ると T_c^{A2-B2} と T_c^{A2-L2} ともに500°Cを下回る.このような規 則変態温度の低下は、必然的に L2₁相の規則度の低下を伴 うと予想される.実際、約 16 at% Al を境にして、高 Al 側 では水焼入れしても L2₁規則化を阻止できないが、16 at% Al 以下の組成では水焼入れにより不規則 A2 構造が凍結さ れる.L2₁相および A2 相から生じるマルテンサイトは、そ れぞれ 6 M 長周期積層構造と fcc-A1 構造である⁽¹⁶⁾.

図6は、Cu-Al-Mn β 単相合金の冷間加工性,引張破断伸 び,形状記憶特性についてAl濃度の影響を示したものであ る⁽¹⁵⁾.ここで,冷間加工性は,途中焼鈍せずにクラックが 出現する直前まで冷間圧延した場合の最大圧下率と定義して いる.また、形状記憶特性は,液体窒素温度で約0.2 mm 厚 の板材に表面歪で2%の曲げ変形を加え,200℃まで加熱し た場合の回復率によって評価している.図からわかるよう に,冷間加工性,引張破断伸び,形状記憶特性のいずれにつ いても9 Mn~13 Mn の範囲内では Mn 濃度にあまり依存し ていない.一方,Al濃度には大きく依存し,特に冷間加工 性はAl濃度が21 at%以下の領域から急激に上昇し,不規則 構造となる16 at%に至っては80%程度の冷間加工性が得ら れる.Ti-Ni 合金や Cu-Zn-Al 合金では,同様の手法により 評価される冷間加工率は高々20~30%止まりであることか ら,形状記憶効果もさほど低下せず良好な加工性および機械 特性が得られる17~18%Al 合金が,新しいタイプの高加工 性 Cu 基合金の候補として有望であることが見出された.

以上の知見を基に,超弾性特性と組織因子について調査した結果,結晶粒径制御⁽¹⁷⁾と集合組織制御⁽¹⁸⁾により,Ni-Ti 合金と同レベルの特性を得る事ができた.詳細は原論文や解





説⁽¹⁵⁾を参照していただきたい. 粒径制御は良好な超弾性特 性を得るために重要な組織因子であるが、これを利用して医 療材料に応用した例を紹介する. 陥入爪(あるいは巻き爪)は 10人に1人の潜在的患者がいると言われておりテレビや新 聞などマスコミでも度々取り上げられている. これまでいろ いろな治療法が考案されているが、Cu-Al-Mn 合金の超弾 性特性を利用した陥入爪矯正器具を開発し、すでに病院や開 業医院で使用されている⁽¹⁹⁾.図7は実際にこの矯正器具で 治療した例を示しているが、装着時に爪が湾曲して食い込み が強く、大きな痛みを伴ったものが1週間~2週間装着する 事によって爪がだんだん平らになり疼痛の軽快が認められ た. このデバイスは殆どの患者に効果があり、クリップすれ ばよいので着脱が容易である事が大きな特徴である. このデ バイスは本合金が図6に示すように冷間加工性が極めてよ いので、板材やクリップ形状に容易に加工できる事より商品 化に成功した好例である.



図 6 Cu-Al-(9~13)at%Mn 合金のβ単相試料の形状 回復率,冷間加工性および破断伸び.



図7 Cu-Al-Mn 超弾性合金の陥入爪矯正器具を使った臨床像. (a) 装着時,(b) 開始時,(c) 一週間後,(d) 二週間後.



図 8 M_s , A_f , T_c の組成依存性. (a) $Ni_{50}Mn_{50-x}In_x$, (b) $Ni_{50}Mn_{50-x}Sn_x$, (c) $Ni_{50}Mn_{50-x}Sb_x$.

(2) Ni-Mn 基メタ磁性形状記憶合金

Ni-Mn 2 元系の高温で出現する B2 構造の NiMn 化合物 は In や Sn 等の第3元素の添加によって更に規則化したホ イスラー化合物を形成し、強磁性を示すことは知られてい た. 著者らは Ni-Mn-X(X: In, Sn, Sb)のホイスラー相の安 定性を調べ、強磁性母相から弱磁性マルテンサイト相へ変態 することを見出した⁽²⁰⁾⁻⁽²²⁾.図8は、Ni濃度を50 at%とし、 Mn 原子と X 原子 (X: In, Sn, Sb) を置換した際の T_c(キュー リー点), M_s(変態開始点), A_f(逆変態終了点)を示してい 度の増加とともに低下し、母相のT_cは強い組成依存性を示 さないが、マルテンサイト相の Tcは X が減ると急激に減少 する. 図9にはキューリー温度を上げるために Coを添加し たNi₄₅Mn_{36.6}In_{13.4}Co₅合金の熱磁曲線と200-320Kでの磁 化曲線を示している⁽²¹⁾. 0.05 T の磁場下で冷却する場合, 母相のキューリー温度で磁化が増加するが、室温付近で磁化 が突然消滅している.この変化はマルテンサイト変態による ものである.印加磁場を強くすると、母相の磁化は増大する がマルテンサイト相の磁化は殆ど変化しない. また, $M_{\rm s}$, $A_{\rm f}$



図 9 磁場印加時の Ni45 Mn36.6 In13.4 Co5 合金の熱磁曲線.



図10 Ni₄₅Mn_{36.6}In_{13.4}Co₅合金の種々の温度における磁 化曲線.

は印加磁場が強くなるほど低下する.この現象は,ゼーマン エネルギーにより磁化の小さいマルテンサイト相よりも磁化 の大きな母相の方が相対的に安定化するためと考えられる. さらに,250-300 K の間で磁場をかければ弱磁性マルテン サイト相から強磁性母相への磁場誘起変態(メタ磁性相転移) の出現が期待されるが,実際それは図10に示すように270, 290 K において確認された⁽²¹⁾.この現象より,マルテンサ イト相状態で変形し磁場を加えれば,逆マルテンサイト変態 により形状回復を生じることも確認した.著者らは,この様 な磁場誘起逆変態に起因する形状記憶効果をメタ磁性形状記 憶効果と命名した.今後,このような新材料はセンサーやア クチュエータ材料への応用が期待される.

以上の様な新形状記憶材料の造り込みに当たっては、マル テンサイト変態温度等の制御が不可欠となってくる.熱弾性 型マルテンサイト変態における母相とマルテンサイト相間の 熱力学的平衡温度 $T_0 = (A_f + M_s)/2$ は、データベースさえ完 備されていれば計算状態図から容易に推測できるので、2 相 平衡を利用した組織制御ばかりでなく、マルテンサイト変態 制御においても CALPHAD 法は有用であることを強調した い.

4. Co 基超耐熱合金

現在超耐熱合金として使用されているのは Ni 基スーパー アロイであり、その強化相は L12 構造の y' 相の Ni₃Al 化合 物である. Co 基合金においては Co₃Ti の L1₂ 相が安定相と して出現するが融点も低いために耐熱合金としての利用は困 難である.従って Co 基耐熱合金は固溶強化や炭化物の析出 強化による方法しか使えないため, Ni 基スーパーアロイの 様な高温での使用に限界があった.最近,著者らは,Co-Al-W 系において図11に示す様に立方体状の析出物が均一か つ微細に分散した組織を確認したが⁽²³⁾,Ni基超耐熱合金に 観察される y+y'2相組織と酷似している.図11に示す電子 線回折パターンから、この析出物の結晶構造は Ni₃Al と同じ $L1_2$ 構造と同定され、Ni 基超耐熱合金と同じ y + y' 2 相組織 であることが明らかとなった.著者らが決定した900℃にお ける Co-Al-W 系状態図を図12に示す⁽²³⁾. Co-Al, Co-W 各 2元系では安定相としてのL12構造のy'相は状態図には現 れない. 1000℃では,熱処理時間が短い場合は γ'相を確認



図11 Co-9Al-7.5W(at%)を900℃で72時間熱処理した TEM 像.



できるが,長時間熱処理を行うことにより消失してしまうた め y' 相は準安定であると考えられる.一方,900℃の場合, 加工熱処理や長時間熱処理を行っても y' 相は残存している のでかなり安定であると考えられる.この y' 相の領域はご く狭い組成範囲であるが Al と W をほぼ等量ずつ含んでい る.このような安定な3元化合物の発見は,計算だけで推 測することは困難であり,地道な実験が必要であることを示 唆している.

y' 相の Co₃(Al, W)化合物の特性も少しずつ明らかにされ てきている. **表 2**は y' 相の弾性定数の実験値⁽²⁴⁾および第一 原理計算⁽²⁵⁾⁽²⁶⁾結果を示している. Co₃(Al, W)の y' 相は Ni 基の y' 相と類似の弾性定数を採る事より Ni 基と同様の強化

表2 y'相の弾性定数.

	温度 (K)	$\begin{array}{c} C_{11} \\ (Gpa) \end{array}$	$\begin{array}{c} C_{12} \\ (Gpa) \end{array}$	$\begin{array}{c} C_{44} \\ (Gpa) \end{array}$
$Co_3(Al, W)$ Experiment [24]	5	271	172	162
$\begin{array}{c} Co_3(Al, W) \ Calculation \\ \llbracket 25 \end{bmatrix}$	0	363	190	212
	0	264	162	153
$\underset{[24]}{Ni_3(Al, Ta)}$ Experiment	5	238	154	130

()

(a) 単結晶

	温度 (K)	$\begin{array}{c}Bh\\(Gpa)\end{array}$	$\mathop{Gh}\limits_{(Gpa)}$	Eh (Gpa)	ν
$Co_3(Al, W)$ Experiment [24]	5	205	101	260	0.289
$Co_3(Al, W)$ Calculation [25]	0	248	148	370	0.251
$Co_3(Al, W)$ Calculation $[26]$	0	196	99	253	0.284
$\ensuremath{\operatorname{Ni}}_3(\ensuremath{\operatorname{Al}},\ensuremath{\operatorname{Ta}})$ Experiment [24]	5	182	82.8	216	0.303

Bh:体積弾性率 Gh:剛性率 Eh:ヤング率 v:ポアソン比



図13 各種 L12 化合物の0.2% 耐力の温度依存性.



図14 各種耐熱合金の0.2%耐力の温度依存性.

相として期待できる.

図13は Co₃(Al, W) y' 相の0.2%耐力の温度依存性を示して いる⁽²⁷⁾. この化合物も他のL1₂相と同様に耐力の逆温度依 存性を示し,特に約800Kより高い温度で高い応力を示 す.図14は各種耐熱合金の0.2%耐力の温度依存性を示す が⁽²⁸⁾, Co₃(Al, W)の y' 相で強化した合金は873K以上で Ni 基スーパーアロイと同等以上の高い強度を示している. Co 基合金の y 相と y' 相間の合金元素の分配挙動を調査する と, Ta, Nb, Ti などの元素は y' 相に多く分配する強力な y' フォーマーであり,これらの合金元素の分配挙動は, Ni 基合金の場合と極めて類似している⁽²⁹⁾.従って Ni 基超合金 の設計手法が Co 基超合金に対しても十分適用すると考えら れるので,今後の進展に期待したい.

5. 液相2相分離合金

「水と油」のように液相で2相分離を示す系は合金やセラ ミックスでも多い. Al-Pb や Cu-Pb 合金など潤滑に優れた ベアリング材として使用されている場合もあるが、多くの液 相2相分離合金は工業的に利用する事が困難であると考え られてきた. その理由として2つの液相の密度は一般に異 なるため, どうしても重力のために分離してしまう事が挙げ られる. 著者らは液相2相分離型合金のガスアトマイズし た粉末を作製し、その組織形態を調べた結果、図15に示す様 に状態図と密接な関係がある事がわかった⁽³⁰⁾⁽³¹⁾. すなわ ち,液相の2相分離領域の臨界組成を境にして,(i)A-rich 側とB-rich リッチ側の組成域でコア相とシェル相が逆転す ること, また, (ii)2相分離領域の両端近傍の組成では, 第2 相が母相中に微細かつ均一に分散した粉末が得られることを 明らかにした. 典型的な組織を図16(a)に示す. この様な卵 型構造の組織形成は、これまで無重力状態での実験では確め られていたが、通常の重力下においては初めて発見された現 象である.この特異な組織は、図16(b)に示したように、体 積分率が少ない第2相液相粒子がマランゴニ効果によって 中央部に凝集・合体する結果,コア相とシェル相の2相に



図15 液相2相分離型合金粉末の組織形態と状態図と の関係.

(a) Cu-31.4Fe-3Si-0.6C (質量 %)





図16 Cu-31.4Fe-3Si-0.6C(at%)合金粉末組織とその 組織形態の模式図.



図17 (a) Bi-Sn-Cu 3 元系の650℃における液相2相分離. (b) Bi-35Cu-15Sn(mass%)とおよび(c) Bi-10Cu-5Sn(mass%)合金粉末のミクロ組織.

分離して形成される.この様な組織は、粉末だけでなくCu-Fe-X 基多元系合金の円柱状の鋳造インゴットにおいても Cu-rich 相と Fe-rich 相が、円柱の芯部と外周に明瞭に2相 分離することを確認している⁽³²⁾⁽³³⁾.この様な特異な組織を 有する粉末を利用すれば、異なる機能を有するコア相とシェ ル相を適切に配置してハイブリッド化することにより、さま ざまな用途への応用が期待できる.ここでは、著者らが開発 したはんだ合金の熱力学データベース ADAMIS(<u>Alloy Da</u> tabase for <u>Micro-Solders</u>)⁽³⁴⁾⁽³⁵⁾を利用して、液相の2相分 離を予測し合金設計を行った Bi-Cu 基合金⁽³¹⁾の組織制御を



図18 Ag-Cu-Ni 合金粉末の組織形態と液相2相分離と の関係.

紹介する. Bi 基合金は融点が270℃程度の高温 Pb フリーは んだとしての応用が期待されている⁽³⁶⁾⁽³⁷⁾. Bi は Al, Cu, Zn などの元素と,液相が相分離する傾向を有していることか ら,卵型あるいは微細分散型のハイブリッド粉末の組織形成 が期待できる.図17に Bi-Cu-Sn 系の液相分離曲線とガスア トマイズ法により作製した急冷粉末の断面組織を示す⁽³¹⁾. 図17(a)の〇印で示した2相分離線中央付近の組成では,卵 型組織が形成されており,一方相境界線に近い×印の組成で は分散組織を呈しており,図15の関係が3元系でも適用さ れることを示している.

上述した Pb フリーはんだの候補材料以外にも,Ag-Cu-X(X=Co, Fe, Ni)3元系合金において,液相の相分離が計算 状態図より予測されており,Ag-rich 相を外殻に,X-rich 相を内核に分離させることによって,近年高騰が著しいAg 使用量削減の効果が期待できる.一例としてAg-Cu-Ni合 金の2相分離線と粉末組織との関係を図18に示す⁽³⁸⁾.これ らの卵型や分散型粉末より作製したAg-Cu-X合金焼結材は 比抵抗が小さくAg量を低減させた導電性フィラー等への応 用が期待できる.また,これらの卵型組織はPhase field 法 によってシミュレーションできる状況になっている⁽³⁹⁾.

6. おわりに

鋼中の硫化物, Cu および Ni 基形状記憶合金および Co 基 耐熱合金,そして液相2相分離系の状態図とそれを利用し た合金設計ついて紹介した.3元系合金でも未だに状態図さ え確立されていない系も多いので,新しい3元化合物の発 見等が期待されるが,やはり地道に基礎データを積み重ねる と同時に,多元系の相安定性を精度良く推定する手法の開発 が望まれる.

最後に、これまでご指導いただいた西澤泰二東北大学名誉

教授に厚く御礼申し上げる.本稿は東北大学貝沼亮介教授, 及川勝成准教授,大沼郁雄准教授,須藤祐司准教授,大森俊 洋助教を始め,多くの研究員,学生諸君との共同研究の成果 によるものであり,心から感謝申し上げる.

文 献

- M. Hansen and K. Anderko: Constitution of Binary Alloys, McGraw–Hill, (1958).
- (2) 西澤泰二:日本金属学会会報, 31(1992), 389-397.
- (3) T. Mohri: Alloy Physics, ed. W. Pfeiler, WILEY-VCH, (2007), 525–588.
- (4)石田清仁:第198回西山記念技術講座,日本鉄鋼協会(2009), 47-72.
- (5)及川勝成,大沼郁雄,貝沼亮介,石田清仁:日本金属学会誌, 72(2008),545-556.
- (6)金子秀夫,西澤泰二,玉置維昭:日本金属学会誌,27(1963), 312-318.
- (7) K. Oikawa, H. Mitsui and K. Ishida: Mater. Sci. Forum, 500– 501 (2005), 711–718.
- (8) H. Ohtani, K. Oikawa and K. Ishida: High Temp. Mater. Processing, 19(2000), 197–210.
- (9) R. Vogel and W. Hotop: Arch. Eisenhuttenwes., **11**(1937), 41– 54.
- (10)及川勝成,大沼郁雄,石田清仁:ふぇらむ,9(2004),900-904.
- (11) K. Oikawa, H. Mitsui, T. Ebata, T. Takiguchi, T. Shimizu and K. Ishida: ISIJ Int., 42(2002), 806–807.
- (12) T. Ebata, T. Takiguchi, T. Shimizu, K. Oikawa, H. Mitsui and K. Ishida: Adv. Eng. Mater., 6(2004), 889–893.
- $(13)\,$ W. Koster and T. Godecke: Z. Metallkd., $\mathbf{57}(1966),\,889\text{--}901.$
- (14) R. Kainuma, N. Satoh, X. J. Liu, I. Ohnuma and K. Ishida: J. Alloys Compd., 266 (1998), 191–200.
- (15)須藤祐司,大森俊洋,貝沼亮介,石田清仁,山内 清:まて りあ,42(2003),813-821.
- (16) R. Kainuma, S. Takahashi and K. Ishida: Metall. Mater. Trans. A, **27A**(1996), 2187–2195.
- (17) Y. Sutou, T. Omori, Y. Yamauchi, N. Ono, R. Kainuma and K. Ishida: Acta Materialia, 53 (2005), 4121–4133.
- (18) Y. Sutou, T. Omori, R. Kainuma, N. Ono and K. Ishida: Metall. Mater. Trans., 33A (2002), 2817–2824.
- (19) 田畑伸子,石橋昌也,末武茂樹,大森俊洋,須藤祐司,貝沼 亮介,山内 清,石田清仁:皮膚科の臨床,50(2008),491-496.
- (20) Y. Sutou, Y. Imano, N. Koeda, T. Omori, R. Kainuma, K. Ishida and K. Oikawa: Appl. Phys. Lett., 85(2004), 4358– 4360.
- (21) R. Kainuma, Y. Imano, W. Ito, Y. Sutou, H. Morito, S. Okamoto, O. Ktakami, K. Oikawa, A.Fujita, T. Kanomata and K. Ishida: Nature, 439 (2006), 957–960.

- (22) K. Oikawa, W. Ito, Y. Imano, Y. Sutou, R. Kainuma, K. Ishida, S. Okamoto, O. Kitakami and T. Kanomata: Appl. Phys. Lett., 88 (2006), 122507–1–1225–7–3.
- (23) J. Sato, T. Omori, K. Oikawa, I. Ohnuma, R. Kinuma and K. Ishida: Science, **312**(2006), 90–91.
- (24) K. Tanaka, T. Ohashi, K. Kishida and H Inui: Appl. Phys. Lett., 91 (2007), 181907–9.
- (25) Q. Yao, H. Xing and J. Sun: Appl. Phys. Lett., 89(2006), 161906-8.
- (26) C. Jiang: Scripta Mater., **59**(2008), 1075–1078.
- (27) S. Miura, K. Ohkubo and T. Mohri: Mater. Trans., 48(2007), 2403–2408.
- (28) A. Suzuki and T. M. Pollock: Acta Mater., 56(2008), 1288– 1297.
- (29) C. C. Jia, K. Ishida and T. Nishizawa: Metall. Mater. Trans. A, 25A (1994), 473–485.
- (30) C. P. Wang, X. J. Liu, I. Ohnuma, R. Kainuma and K. Ishida: Science, 297 (2002), 990–993.
- (31) Y. Takaku, I. Ohnuma, R. Kainuma, Y. Yamada, Y. Yagi, Y. Nishibe and K. Ishida: J. Electronic Mater., 35(2006), 1926– 1932.
- (32) C. P. Wang, X. J. Liu, Y. Takaku, I. Ohnuma, R. Kainuma and K. Ishida: Metall. Mater. Trans. A, **35A**(2004), 1243–1253.
- (33) C. P. Wang, X. J. Liu, I. Ohnuma, R. Kainuma and K. Ishida: J. Mater. Res., 23 (2008), 933–940.
- (34) I. Ohnuma, X. J. Liu, H. Ohtani and K. Ishida: J. Electronic Mater., 28(1999), 1164–1171.
- (35) X. J. Liu, I. Ohnuma, C. P. Wang, M. Jiang, R. Kainuma, K. Ishida, M. Ode, T. Koyama, H. Onodera and T. Suzuki: J. Electronic Mater., 32(2003), 1265–1271.
- (36) I. Ohnuma, T. Saegusa, Y. Takaku, C. P. Wang, X. J. Liu, R. Kainuma and K. Ishida: J. Electronic Mater., 38(2009), 2–9.
- (37) Y. Yamada, Y. Takaku, Y. Yagi, I. Nakagawa, T. Atsumi, M. Shirai, I. Ohnuma and K. Ishida: Microelectronics Reliability, 47 (2007), 2147–2151.
- (38) Y. Takaku, K. Makino, K. Watanabe, I. Ohnuma, R. Kainuma, Y. Yamada, Y. Yagi, I. Nakagawa, T. Atsumi and K. Ishida: J. Electronic Mater., 38 (2009), 54–60.
- (39) C. P. Wang, X. J. Liu, R. P. Shi, C. Chen, Y. Wang, I. Ohnuma, R. Kainuma and K. Ishida: Appl. Phys. Lett., 91(2007), 141904–1–3.



石田清仁